



【台股盤前 0626】美光財報引爆記憶體、費半勁揚逾 3%；蘋果鏈與通膨拖累那指

美股分化、台指期夜盤小漲，台股今日料開高但盤面分歧！

一、美股 / 國際盤勢

昨夜美股呈現「半導體獨強、權值科技與大盤分化」的格局。美光（MU）公布上季營收 414.6 億美元，年增約 346%，調整後每股盈餘 25.11 美元，雙雙優於市場預期，且本季財測同步轉強，帶動股價收盤大漲約 15.6%。美光財報強化市場對 AI 記憶體需求與資料中心資本支出的信心，記憶體與半導體設備股同步受惠，費城半導體指數收漲 3.59%，成為盤面最強主軸。

不過，大盤並未全面轉強。美國 5 月整體 PCE 年增升至 4.1%，核心 PCE 年增 3.4%，顯示通膨壓力仍高，降息預期受壓；加上蘋果（AAPL）因宣布調漲 MacBook、iPad 等產品售價，市場擔心記憶體成本上升侵蝕終端需求，股價重挫約 6.3%，拖累大型科技股與那斯達克表現。最終美股收盤分歧，道瓊小漲，標普近乎持平，那斯達克收黑，代表資金雖回補半導體，但尚未擴散成科技股全面反攻。四大指數因此明顯分歧：

指數	收盤	漲跌幅
道瓊工業	51,920.62	▲ 0.14%
那斯達克	25,358.60	▼ 0.46%
標普 500	7,357.49	▼ 0.01%
費城半導體	13940.87	▲ 3.59%

對台股而言，昨夜美股是一份「半導體強、但風險偏好未全面擴散」的隔夜成績單。美光財報優於預期，強化市場對 AI 記憶體需求與資料中心資本支出的信心，帶動費城半導體指數收漲逾 3%，記憶體與部分晶片族群同步轉強。

這對台股記憶體、半導體設備與 AI 供應鏈是正面訊號；對台積電（2330）則屬半導體情緒利

多，但仍需觀察外資賣壓是否收斂，以及台積電能否帶量接棒。另一方面，記憶體漲價邏輯雖有利上游供應商，卻也墊高終端品牌成本，蘋果因調漲 MacBook、iPad 售價引發市場對終端需求的疑慮，蘋果概念股與組裝代工鏈今日需留意壓力。

二、台股盤前觀點

今日盤前定調為「開高有機會，但分化加劇，追高仍需謹慎」。昨夜美光財報優於預期，點燃 AI 記憶體需求與資料中心資本支出題材，帶動費城半導體指數收漲約 3.6%。台股今日主軸可先看記憶體、載板、半導體設備與部分 AI 供應鏈是否延續買盤，但不宜直接解讀為電子股全面轉強。

壓力有兩道。第一，外資籌碼尚未轉多，6/24 外資單日賣超 1,774.18 億元，創史上最大賣超紀錄，6/25 又賣超 405.10 億元，兩日合計提款逾 2,100 億元；在外資賣壓未明顯收斂前，指數開高後仍容易遇到調節賣壓。第二，美國 5 月核心 PCE 年增 3.4%、整體 PCE 年增 4.1%，通膨仍高，使降息預期受壓；加上那斯達克收黑，代表資金雖回補半導體，但尚未擴散成大型科技股全面反攻。

操作上，今日不宜用「費半上漲」直接追高整體電子股，應觀察記憶體、載板與半導體設備開高後是否能帶量續強；若台積電與高評價權值股無法接棒，盤面仍可能呈現「半導體題材股強、蘋果鏈與高基期權值分化」的格局。短線以開高後承接力、外資賣超是否收斂、台指期是否守穩現貨關鍵支撐作為盤中判斷依據。台股前一交易日表現如下：

項目	數值
加權指數	46,255.26 (+211.66, +0.46%)
成交金額	約 1.37 兆元
台積電 (2330)	收 2390 元
外資近期動向	連三日大賣、6 月來賣超逾 4,500 億元
台指期末平倉空單	81,051 □

前一交易日（6/25）台股受美光財報優於預期激勵，記憶體與載板族群接棒走強，加權指數終場上漲 211.66 點，收在 46,255.26 點，成交金額約 1.37 兆元。盤面上，記憶體、ABF 載板與電子零組件為資金主軸，聯茂、南電等多檔電子零組件亮燈漲停，金融股同步走強撐盤；台積電（2330）則收在 2,390 元平盤，尾盤賣壓壓抑指數漲幅，呈現「電子次族群輪動、權值股追價不

足」的格局。

操作上，今日若開高，主要是反映美光財報與費半走強帶來的半導體情緒利多，但在外資連續大賣、台指期淨空單仍處高檔、且隔夜那斯達克收黑的背景下，開高後的分化與量能比指數紅 K 更重要。記憶體、載板與半導體設備若能帶量領漲，且外資現貨賣超明顯收斂，才有助多方挑戰前波高檔反壓區；反之，若蘋果鏈與高評價權值股補跌、外資續站賣方，指數容易高開後震盪收斂。操作上宜汰弱留強，不追高開高急拉股，也避免重壓單一族群。

選股邏輯與焦點股

今日選股邏輯以「美光財報的直接受惠鏈」為核心：記憶體報價（DRAM/HBM）續揚、AI 伺服器拉貨延續，最惠者依序是記憶體模組與利基型 DRAM、ABF 載板與高階 PCB、以及半導體權值。具體可留意南亞科 (2408)、華邦電 (2344) 作為記憶體題材主攻；載板與 PCB 族群留意南電 (8046)、欣興 (3037)、聯茂 (6213) 的接棒延續；半導體權值則以台積電 (2330) 是否帶量站回均線作為大盤多空指標。反向須留意的是蘋果鏈：記憶體漲價墊高終端成本、蘋果隔夜重挫 6%，鴻海 (2317) 等組裝代工今日易受情緒牽動。提醒上述強勢股多已先漲一段，今日開高後應看「是否帶量續攻」，而非單看跳空紅 K。

台股指數研判

加權指數前一日收在 46,255.26 點，重返 46,000 點之上，但短線仍未擺脫上方均線與前波套牢壓力。今日若開高，第一道反壓先看前一日盤中高點附近的 46,700~46,800 點區間，需帶量站穩，才有機會進一步挑戰 47,000 點整數關卡；下方支撐則先看 46,000 點與前一日低點 46,048 點附近，若跌破 46,000 點，前一日反彈容易被視為跌深後的短線修正。

台積電 (2330) 能否止穩走高仍是盤面風向球。前一日台積電收在 2,390 元平盤，尾盤賣壓壓抑指數漲幅，代表權值股尚未全面接棒。今日若台積電能帶量走高，搭配記憶體、載板與半導體設備延續買盤，指數才有挑戰上方反壓的條件；若台積電續弱，即使題材股開高，指數仍容易開高震盪。

籌碼面仍是主要壓力。外資現貨連續大賣尚未明確轉向，台指期淨空單在前一日創高後仍處高檔，加上隔夜那斯達克收黑，盤前不宜直接定調偏多。今日指數以「開高震盪、反彈測壓」看待，操作上沿短均線與 46,000 點支撐觀察，開高急拉不追價；若量能不足、外資續賣，或指數跌破 46,000 點，持股應減碼，汰弱留強。

產業強弱觀察

- **相對強勢**：記憶體（南亞科 2408、華邦電 2344）、ABF 載板與 PCB（南電 8046、欣興 3037、聯茂 6213）、半導體權值（台積電 2330）、金融保險。
- **相對弱勢**：蘋果概念與組裝代工鏈（鴻海 2317，記憶體漲價墊高成本）、前波漲多的高本益比 AI 概念股（留意獲利了結）、對殖利率走升敏感的高評價成長股。

三、今日盤勢結論

今日台股基調為「開高分化、追高謹慎」。隔夜美光財報優於預期，點燃 AI 記憶體需求與資料中心資本支出題材，帶動費城半導體指數收漲 3.59%，加上台指期夜盤一度翻紅，給記憶體、載板與半導體設備族群開高底氣，這是今日最明確的攻擊主軸。

但這並非全面性風險偏好。那斯達克收黑，蘋果因調漲售價引發終端需求疑慮而重挫，加上美國 5 月核心 PCE 年增 3.4%、整體 PCE 年增 4.1%，通膨壓力仍高，降息預期受壓。台股自身籌碼也尚未轉多，外資本周才創下史上最大單日賣超，台指期淨空單前一日創高後仍維持高檔，籌碼與通膨仍是壓在多方頭上的兩個變數。

策略上，開高不代表轉強，仍要以「量能與分化」驗證強弱。記憶體、載板與半導體設備若能帶量領漲，且外資現貨賣超明顯收斂，才是反彈延續訊號；若蘋果鏈補跌、外資續賣、量能未放大，指數容易回到區間震盪。操作上以汰弱留強為主，不追高開高急拉股，並控制單一族群部位。

免責聲明

本內容僅供參考與教育用途，不構成任何投資建議或買賣要約。所載數據來自公開來源整理，本文不保證其即時性、真實性與完整性；市場有風險，投資人應審慎評估自身狀況與風險承受度，並自行對投資決策負責。